

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 2 月 10 日 (10.02.2005)

PCT

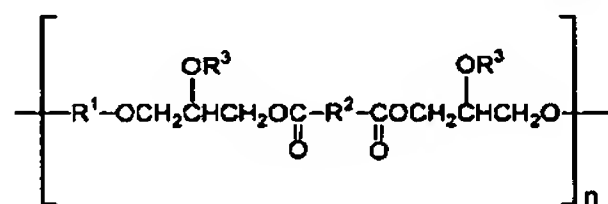
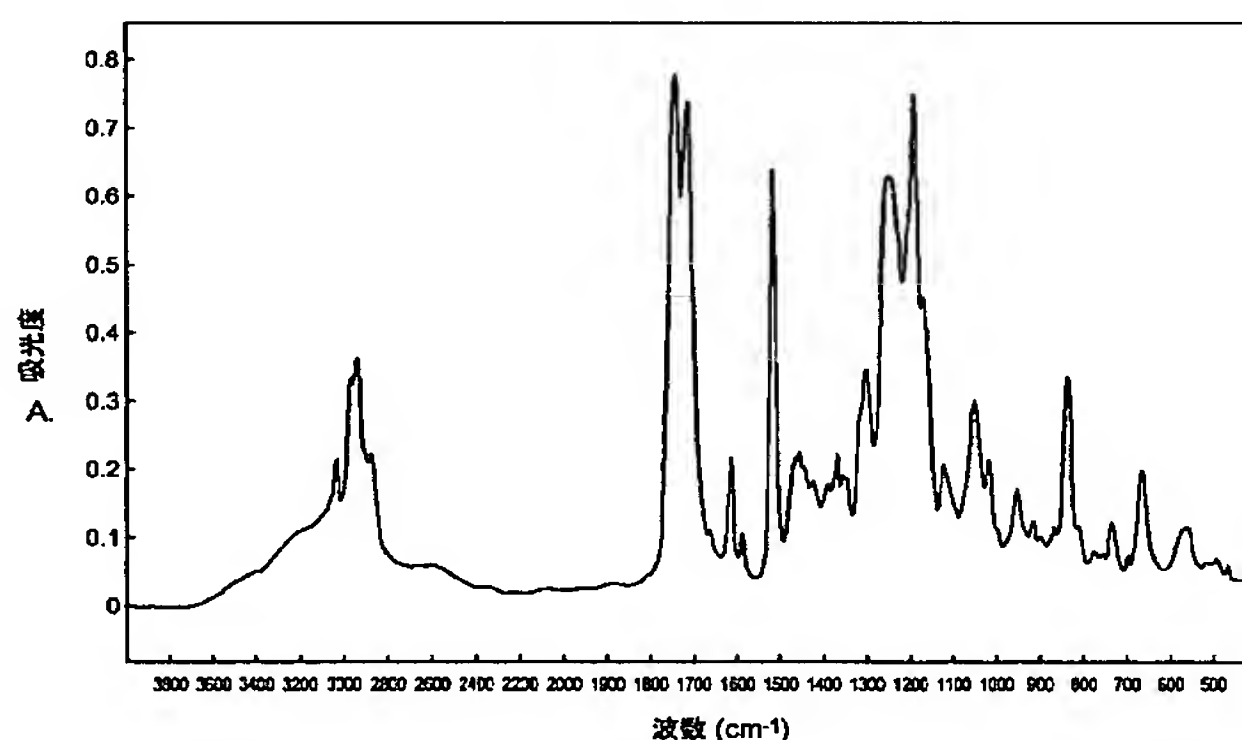
(10) 国際公開番号  
WO 2005/012384 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C08G 59/14
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009439
- (22) 国際出願日: 2004 年 7 月 2 日 (02.07.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2003-284424 2003 年 7 月 31 日 (31.07.2003) JP  
特願2004-071349 2004 年 3 月 12 日 (12.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 板垣 秀一 (ITAGAKI, Shuuichi) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 土屋 勝則 (TSUCHIYA, Katsunori) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 吉田 哲也 (YOSHIDA, Tetsuya) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 塚田 勝重 (TSUKADA, Katsusige) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日化テクノサービス株式会社内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0 番 6 号銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: MODIFIED EPOXY RESIN, PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF, PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITIONS AND PHOTSENSITIVE ELEMENTS

(54) 発明の名称: 変性エポキシ樹脂、その製造方法、感光性樹脂組成物及び感光性エレメント



A...ABSORBANCE  
B...WAVENUMBER (cm<sup>-1</sup>)  
(1)



(57) Abstract: A modified epoxy resin having repeating units represented by the general formula (1): wherein R<sup>1</sup> is a divalent organic group which is a residue derived from a diglycidyl ether-type epoxy compound; R<sup>2</sup> is a divalent organic group which is a dibasic acid residue; R<sup>3</sup> is hydrogen or a group represented by the general formula (2): (wherein R<sup>4</sup> is an acid anhydride residue); and n is an integer of 1 or above.

(57) 要約: 下記一般式 (1); 【化 1】〔式中、R<sup>1</sup>はジグリシジルエーテル型エポキシ化合物残基である二価の有機基を示し、R<sup>2</sup>は二塩基酸残基である二価の有機基を示し、R<sup>3</sup>は水素原子或いは下記一般式 (2); 【化 2】〔式中、R<sup>4</sup>は酸無水物残基を示す。〕で表される基を示し、nは1以上の整数を示す。〕で表される繰り返し単位を有する変性エポキシ樹脂。

WO 2005/012384 A1



- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

訂正版

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 2 月 10 日 (10.02.2005)

PCT

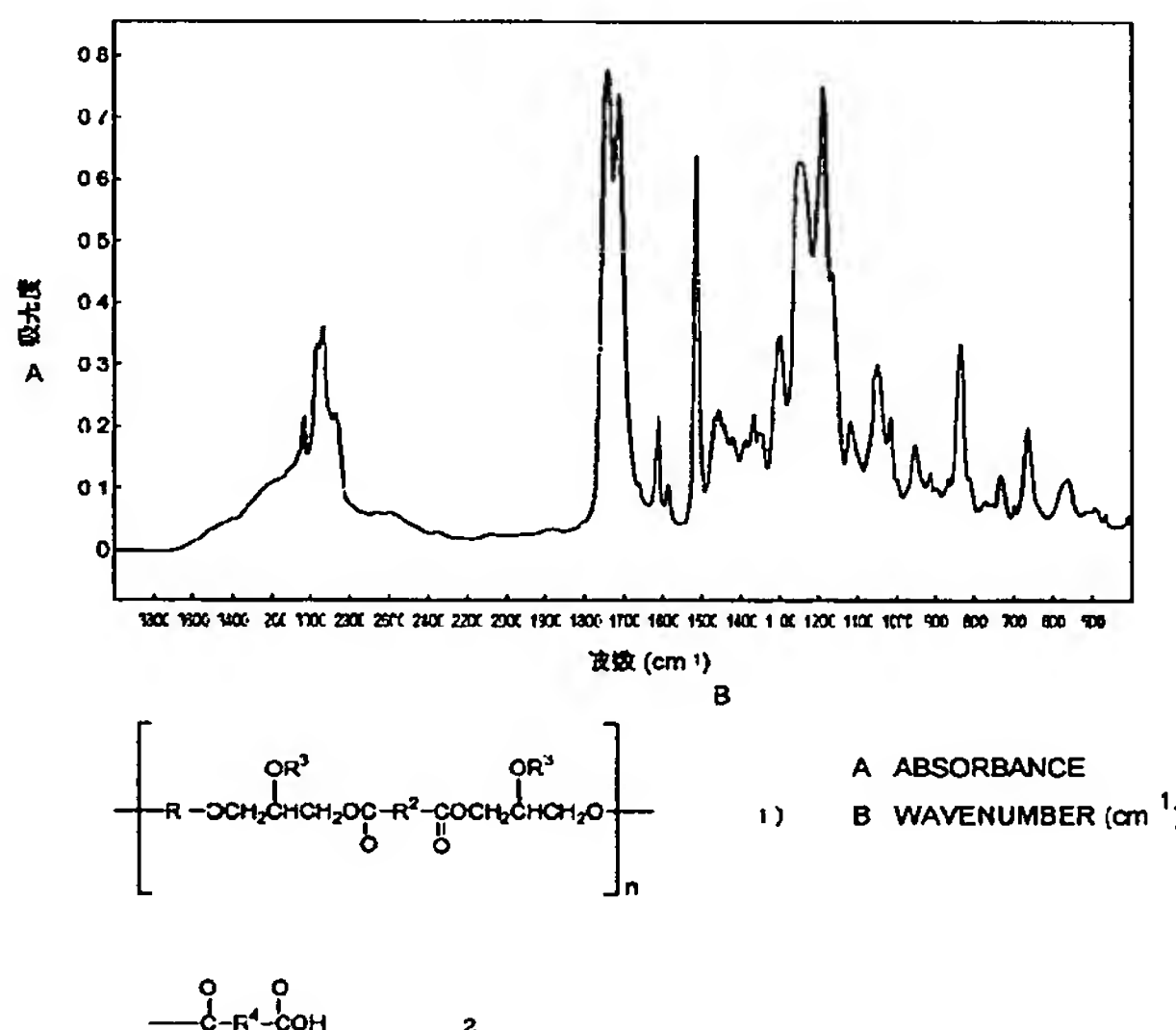
(10) 国  
WO 2005/012384 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C08G 59/14 [JP/JP], 〒1630449 東京都新宿区西新宿 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009439
- (22) 国際出願日: 2004 年 7 月 2 日 (02 07 2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権子ータ:  
特願 2003-284424 2003 年 7 月 31 日 (31 07 2003) JP  
特願 2004-071349 2004 年 3 月 12 日 (12 03 2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.)
- (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 板垣 秀一 (ITAGAKI, Shuuichi) [JP/JP], 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号 日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP) 土屋 勝則 (TSUCHIYA, Katsunori) [JP/JP], 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号 日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP) 吉田 哲也 (YOSHIDA, Tetsuya) [JP/JP], 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号 日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP) 塚田 勝重 (TSUKADA, Katsusige) [JP/JP], 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号 日立テクノサービス株式会社内 Ibaraki (JP)

[続葉有]

(54) Title: MODIFIED EPOXY RESIN, PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF, PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITIONS AND PHOTSENSITIVE ELEMENTS

(54) 発明の名称: 変性エポキシ樹脂、その製造方法、感光性樹脂組成物及び感光性エレメント



(57) Abstract: A modified epoxy resin having repeating units represented by the general formula (1) wherein R<sup>1</sup> is a divalent organic group which is a residue derived from a diglycidyl ether-type epoxy compound, R<sup>2</sup> is a divalent organic group which is a dibasic acid residue, R<sup>3</sup> is hydrogen or a group represented by the general formula (2) (wherein R<sup>4</sup> is an acid anhydride residue), and n is an integer of 1 or above

(57) 要約: 下記一般式 (1), 【化 1】 (式中、R<sup>1</sup> はジグリシジルエーテル型エポキシ化合物残基である二価の有機基を示し、R<sup>2</sup> は二塩基酸残基である二価の有機基を示し、R<sup>3</sup> は水素原子或いは下記一般式 (2), 【化 2】 (式中、R<sup>4</sup> は酸無水物残基を示す。) で表される基を示し、n は 1 以上の整数を示す。) で表される繰り返し単位を有する変性エポキシ樹脂。

WO 2005/012384 A1



(74) 代理人: 長谷川 芳樹 , 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.);  
〒100-0061 東京都中央区銀座一丁目10番6号銀座  
ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護  
が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,  
BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,  
DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FT, GB, GD, GE, GH, GM, HR,  
HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,  
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,  
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可  
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,  
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -X-ラシT (AM, AZ, BY,  
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FT, FR, GB, GR, HU, IE,  
IT, LU, MC, MK, PL, PT, RO, SC, SD, SE, SK, TR), OAPI (BF,  
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,  
TD, TG).

添付公開書類:  
- 国際調査報告書

(48) この訂正版の公開日. 2006年1月26日

(15) 訂正情報:  
PCTガゼットセクションIIのNo. cm/2006 (2006年1月  
26日)を参照

2文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノートJ」を参照。